

Title (en)

Bath for electroplating copper-tin alloys

Title (de)

Bad zum galvanischen Abscheiden von Kupfer-Zinn-Legierungen

Title (fr)

Bain d'électrodéposition d'alliages cuivre-étain

Publication

EP 0698676 A1 19960228 (DE)

Application

EP 95104355 A 19950324

Priority

DE 4426914 A 19940729

Abstract (en)

Bath for galvanically depositing Cu-Sn alloys, consisting of H₂O, Cu-cyanide, Sn (IV) cpd, alkali metal-cyanide, -hydroxide and complex former and additionally contg. alkali metal phosphate, contains the K-salt of gluconic acid, gluconic acid and/or glucuronic acid as complex former and has a pH of 8-14.

Abstract (de)

Glänzende binäre Kupfer-Zinn-Legierungen lassen sich auf galvanischem Wege aus einem wässrigen Bad abscheiden, das Kupfercyanid, Zinn(IV)-Verbindung, Kaliumcyanid, Kaliumhydroxid und das Kaliumsalz der durch Oxidation von Glucose erhaltenen Hydroxysäuren enthält. Die Legierungen eignen sich für technische und dekorative Zwecke, besonders als Ersatz für Nickel.

IPC 1-7

C25D 3/40; **C25D 3/32**

IPC 8 full level

C25D 3/32 (2006.01); **C25D 3/40** (2006.01); **C25D 3/58** (2006.01); **C25D 3/60** (2006.01)

CPC (source: EP)

C25D 3/58 (2013.01); **C25D 3/60** (2013.01)

Citation (search report)

- [DA] DE 3339541 A1 19850515 - DEGUSSA [DE]
- [DA] DE 3346721 A1 19850627 - KARL WILH HEN FA [DE]
- [A] CHEMICAL ABSTRACTS, Columbus, Ohio, US;
- [A] CHEMICAL ABSTRACTS, Columbus, Ohio, US;

Cited by

CN104962959A; IT202100008084A1

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

DE 4426914 C1 19950817; DE 59500711 D1 19971030; EP 0698676 A1 19960228; EP 0698676 B1 19970924

DOCDB simple family (application)

DE 4426914 A 19940729; DE 59500711 T 19950324; EP 95104355 A 19950324